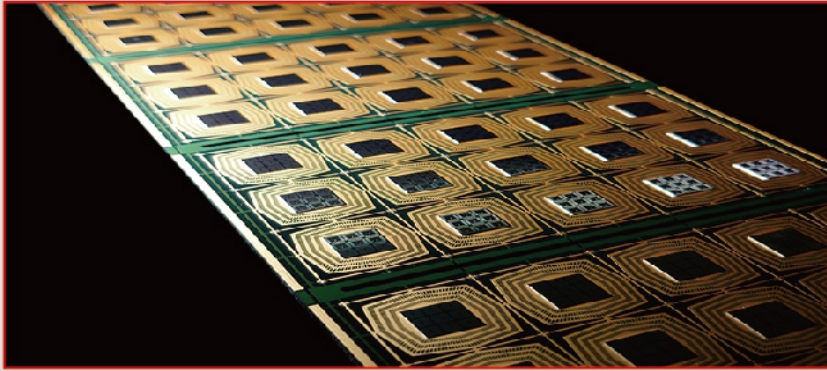


FB-x26

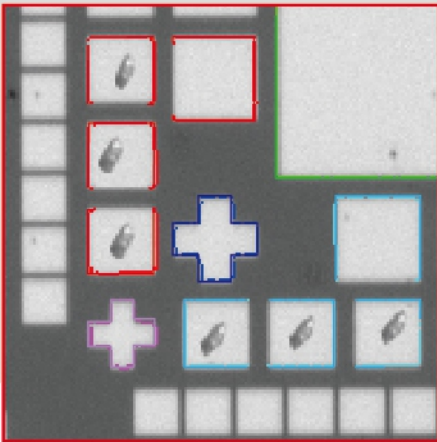
超声波兼用热压合（热超声键合）方式高精度焊线机
Fully Automatic Thermo-sonic Ball Bonder

KAIJO

适用于广泛产品的宽区域对应
Bonding area Y=95mm



新识别算法 α eyes
高速·高精度识别提高生产率
New recognition algorithm



※选配安装规格
※The photograph shows the optional specification

FB-x26 特性

- Y=95mm 超大的焊线区域
Extra large bonding area - Y=95mm
- 提高可追溯功能和自我诊断功能，有助于品质管理和设备维护
Enhanced traceability and Self-diagnosis function - Contribute to quality control and maintenance
- 采用新识别算法 α eyes，提高易受工件影响的识别精度和识别率
Kaijo's latest optimized recognition - Minimize adverse effects from work condition
- 搭载分步焊接功能，通过使接合过程可视化，可实现精准控制
Step Bonding Sequence - Visualized fine process control for enhanced bonding result
- 满足不断提升的连接性和工业 4.0 的需求
SECS/GEM 作为标准配置，亦可使用 KAIJO 自有主机管理系统 KISS
Ready for the growing demand of connectivity and industry 4.0 - SECS/GEM or "KISS" (selectable)

FB-x26

主要规格

焊线性能	
焊接方式	超声波热压焊接（热超声）方式
超声波振荡系统	由 PLL 输出频率自动跟踪振荡系统，单频率
焊线范围	56mm×95mm*
重复位置精度	3σ ≤ 3.0μm**
焊线速度	50msec / wire(2mm 线)**
图像识别功能	
识别方式	可从形状识别方式 (α eyes) 和多值化相关处理方式中选择
检测速度	约 100msec/2 点 (5mm 角芯片时) 约 200msec/4 点 (5mm 角芯片时)
检测率	99% 以上 **
支架定位检测	最快 11msec/1lead
对应工件	
封装 / 支架尺寸	宽度：30mm ~ 105mm 长度：90mm ~ 300mm 高度：0.1mm ~ 0.5mm
料盒尺寸	宽度：30mm ~ 115mm 长度：180mm or 200mm 高度：100mm ~ 175mm 堆叠数量：2-3 个料盒
外部通讯	
	SECS / GEM 搭载 KISS 搭载
电气要求	
电源	单相 AC200V ±5%, 50Hz / 60Hz, 8A (可选择 AC210V, 220V, 230V, 240V, 100V) 最大消费电力：约 1.5kW
干燥压缩空气	压力：0.3 ~ 0.970MPa (3 ~ 9.9Kgf / cm ²)、ISO5 级以上 消费量：40Liters / min 以下
真空	压力：-53.32MPa 以下 (400mm / Hg 以上)
尺寸·重量等规格	
尺寸	宽度：1,065mm 深度：1,186mm 高度：1,728mm (包括信号灯：2,030mm)
重量	重量：约 550kg

*不包括自校准精度
**KAJJO 规定条件下的计算值

SPECIFICATIONS

Bonding	
Process	Ultrasonic with thermocompression bonding
Oscillation	Frequency automatic tracking by PLL. Single frequency.
Bonding area	56mm×95mm*
Repeatability of Bonding Accuracy	3σ ≤ 3.0μm**
Bonding speed	50msec/wire (2mm length Looping)**
Recognition	
Method	Shape recognition (α eyes) or Multi-valued correlation processing (selectable)
Time	Approx. 100msec / 2 points (5mm square chip) Approx. 200msec / 4 points (5mm square chip)
Detection rate	99% or more**
Lead auto-locating (VLL)	11msec / lead
Applicable work size	
Lead frame / Substrate	Width: 30mm ~ 105mm Length: 90mm ~ 300mm Thickness: 0.1mm ~ 0.5mm
Magazine	Width: 30 ~ 115mm Length: 180mm or 200mm Height: 100mm ~ 175mm Stockable: 2 ~ 3 Magazine
External interface	
	SECS / GEM KISS (Kaijo Interconnecting Service System)
Utility	
Power	Single phase AC200V ±5%, 50Hz / 60Hz, 8A (210V, 220V, 230V, 240V, 100V option) Maximum power consumption: Approximately 1.5kW
Dry air	Pressure: 0.3 ~ 0.970MPa (3 ~ 9.9Kgf/cm ²) ISO class 5 or more Consumption: 40Liters / min or less
Vacuum	Pressure: -53.32MPa or less (400mm / Hg or more)
Dimensions	
Width	1,065mm
Depth	1,186mm
Height	1,728mm (To top of signal lamp : 2,030mm)
Weight	Approximately 550kg

*Excluding self-teach accuracy.
** Calculated value under the conditions specified by KAJJO.



KAIJO CORPORATION
東京都羽村市栄町 3-1-5 〒205-8607
3-1-5, Sakae, Hamura, Tokyo, JAPAN 205-8607

URL <https://www.kaijo.co.jp>



深圳汉华半导体科技有限公司
Shenzhen Han Hwa Semiconductor Technology Co., Ltd

地址：深圳市宝安区松岗街道潭头社区恒生工业园第四栋
电话：0755-8524 0596 传真：0755-2300 1062
邮箱：chenyp@hanhwachina.cn
网址：www.hanhwachina.cn



意见栏